

2024深圳国际半导体产业技术展览会

产品名称	2024深圳国际半导体产业技术展览会
公司名称	中展国际
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17620818513

产品详情

2024第二十六届中国国际高新技术成果交易会

半导体产业技术专区

联系方式：请见右上方联系栏

时间：

2024年11月13-17日

地点：

深圳会展中心(福田)

创新驱动发展 智慧赋能未来

主办单位

商务部

科学技术部

工业和信息化部

国家发展改革委

农业农村部

国家知识产权局

中国科学院

中国工程院

深圳市人民政府

联合承办单位

中国机电产品进出口商会

科技部机关服务中心

工业和信息化部国际经济技术合作中心

全国农业科技成果转化服务中心

中国专利保护协会

中科院广州分院

中科院深圳先进技术研究院

国家信息中心

亚洲数据集团

中招国际会展(北京)有限公司

组织单位

广州fce展览服务有限公司

展会介绍

随着智能手机、人工智能、AIoT、智能汽车等新技术的快速发展，物联网应用逐渐规模化落地，安防由高清化向智能化的演进，新能源乘用车等众多行业的兴起，推动了对于半导体需求的持续快速增长，为全球半导体行业增添了新的动力。作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球大和贸易活跃的半导体市场。再加上中国zhengfu对于半导体行业的大力扶持，中国半导体行业发展呈加速态势。“十四五”期间，我国半导体产业将有更全面的发展，并将加快高端芯片设计等领域关键核心技术的突破和应用。随着中国对5G、AI、IoT和云计算、大数据等技术的大量投资，以5G网络、工业互/物联网等为代表的“新基建”将带动半导体产业的高速增长。据预测，到2030年我国的半导体市场供应将达到5385亿美元，依然为全球大，69%的消费量将来自中国本土公司，需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。

作为中国科技创新中心，深圳是我国半导体产品的集散中心、应用中心和设计中心，深圳的半导体产业多年来一直保持高速增长态势，特别是IC设计产业一直位于全国前列。近年来，国内对半导体产业重视力度空前，深圳正作为广东省主阵地打造全国半导体产业第三极，不断加大对半导体产业的政策与资金支持力度。2022年6月，深圳出台“20+8”产业政策，发布了《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》，提出加快完善集成电路设计、制造、封测等产业链条，推动开展EDA工具软件、半导体材料、高端芯片和先进制造等相关重点工程，推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设，高水平打造一批半导体与集成电路产业基地和产业园区。随着政策的发布与实施，在国内5G通信、新能源汽车、工业互联网、大数据、光伏等行业快速发展的大趋势下，以及“碳达峰、碳中和”绿色低碳战略不断推进，第三代半导体市场应用已逐步开启，产业规模不断壮大。

为促进半导体行业新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，推动半导体产业升级，2024高交会半导体产业技术专区展将于2024年11月13-17日在深圳会展中心盛大举办，展会隶属于第二十六届中国国际高新技术成果交易会专区之一，专注于整合半导体行业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为半导体企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案，助力企业实现全产业

链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的半导体产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外半导体行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把脉行业发展方向，直击产品热点、caigou对接。共享国际化大平台，共拓半导体大市场，让我们携手同行，共创商机。

高交会集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体。经过多年发展，高交会已成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口，有“中国科技展”之称，是中国乃至全世界颇具影响力的品牌展会。高交会在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用。半导体产业技术专区作为高交会的重要组成部分，发挥高交会在国际科技交流合作和科技成果产业化等方面的积极作用，为全球半导体产业提供高品质、国际化、综合性的展览体验平台。将更深度探寻半导体产业低碳转型实施路径，更聚焦打造优化产业链供应链布局的交流合作，更直观展现半导体产业智能科技与时尚元素交融带来的感官冲击，更着力构建以科技创新和融合创新为核心驱动的半导体产业生态圈，引入人工智能、元宇宙等前沿科技理念，描绘未来半导体产业给人们生活带来的无限可能。

高交会优势

高交会是目前中国规模颇大、较具影响力的科技类展会，是具有一定国际影响力的品牌展会。

高交会拥有中国zhengfu的强大支持，由多个国家部委院和深圳市人民zhengfu共同举办，多位先后莅临高交会参观指导。首届高交会由时任国务院总理朱镕基宣布开幕，第十届高交会期间，时任国务院总理温家宝专门为高交会题词。

高交会为众多企业带来良好收益，数百家跨国公司先后多次参展，一大批中国民营企业从这里走向世界。

高交会是海内外媒体关注的焦点。每届展会有近200家海内外媒体的约1500多名记者参与报道。不仅包括中国媒体，也有来自海外的主流平面媒体及众多网络媒体。

高交会有强大的推广手段。承办单位专门制订的专项推广计划，新闻发布会、信函直邮和邮件直邮；充分利用多年来与海内外媒体形成的长期合作关系，让海内外企业和客户全面了解高交会。

高交会有优质的观众群体。一直受到海内外人士的热捧，每年的参观人数超过50万人次。

机遇和收获

高交会吸引了众多有技术需求的中外企业、中介机构和数千家投资商，将为专利、技术持有者寻找到来自世界各地的合作伙伴。

高交会每年拥有一万多个高新技术项目参展，将为投资商寻找到新的专利、技术、项目以及大量的投资合作机会。

高交会将为全球高新技术产品和设备生产商寻找到产品快速进入中国市场的渠道。

高交会汇聚了各类创新创业资源，通过卓有成效的项目路演、资本对接、技术交流、经验分享等活动，将为各类创业者提供展示、分享、交流的平台。

高交会上各种机构举办的高端发布会和各种论坛会议、酒会等活动，将为所有参会者提供各种资讯，各种商机。

展品范围

IC设计：IC及相关电子产品设计、IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC设计与设计工具、IC制造与封装、EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计、IDM、Fabless厂等；

芯片：人工智能芯片及方案、电源管理芯片、物联网芯片、5G通信芯片及方案、汽车电子芯片、安全控制芯片、数模混合通讯射频芯片、存储芯片、LED照明及显示驱动类芯片等；